

에이직랜드, '2024 TSMC OIP 생태계 포럼' 첫 참가... 글로벌 협력 강화

- ▶ 대만 OIP 생태계 포럼 참가...GUC, 알칩, SK하이닉스 등 반도체 기업 한 곳에
- ▶ 대만 R&D센터 통한 TSMC, OIP 파트너사들과 지속 협력으로 글로벌 사업 확대

[2024-11-06] 에이직랜드가 2024 TSMC 오픈 이노베이션 플랫폼 생태계 포럼(TSMC OIP(Open Innovation Platform) Ecosystem Forum)에 첫 참가한다.

ASIC(주문형반도체) 디자인솔루션 대표기업 에이직랜드(445090, 대표이사 이종민)가 세계 최대 파운드리(반도체 위탁생산) 기업 TSMC가 개최하는 '2024 TSMC 오픈 이노베이션 플랫폼(OIP) 생태계 포럼'에 참가해 글로벌 비즈니스 협력 기회를 가속화한다고 6일 밝혔다.

이번 포럼은 TSMC 및 OIP 파트너사들의 최신 기술을 공유하고 업계 트렌드와 기술 발전을 탐색하는 자리다. 올해 미국을 포함해 일본, 대만, 중국, 유럽, 이스라엘 등 6개 지역에서 진행되며 GUC, 알칩(Alchip), SK하이닉스 등 750개 기업과 6천명 이상이 참가할 것으로 전망된다. 주요 아젠다로는 AI가 칩 설계 변화에 미치는 영향, 3DIC 시스템 설계 최신 발전 방향 등을 소개할 예정이다.

TSMC는 설계자산(IP) 기업, 설계자동화툴(EDA) 기업, 디자인하우스 등 생태계를 구축해 협업을 통한 효율적인 개발을 거쳐 팹리스에 최적화된 반도체 설계 솔루션을 지원하고 있다. 에이직랜드는 국내 유일 TSMC VCA로 반도체 개발부터 생산까지 원스톱 턴키 솔루션을 제공하고 있다.

에이직랜드는 이번 포럼을 통해 OIP 파트너사들과의 교류를 강화하고, 비즈니스 협력 기회를 확대해 나갈 계획이다. 특히 잠재 고객을 대상으로 한 사업 홍보를 통해 기업 인지도를 제고하고, 마케팅 기회를 확보할 방침이다.

에이직랜드 이종민 대표이사는 "TSMC OIP 생태계 포럼에 첫 참가를 계기로, 곧 설립되는 대만 R&D센터를 발판삼아 TSMC 및 OIP 파트너사들과의 지속적인 협력을 통해 기술 혁신과 글로벌 사업 확장을 이루어 나가겠다"고 밝혔다.

한편, 에이직랜드는 대만 신주시에 첨단 연구개발(R&D) 센터를 설립해 핵심 인재와 3nm~5nm 설계 기술, CoWos(Chip-on-Wafer-on-Substrate) 패키징 기술 확보에 박차를 가하고 있다.



[사진설명] 에이직랜드 TSMC OIP 생태계 포럼 부스 사진



[사진설명] TSMC OIP 생태계 포럼 에이직랜드 부스에서 에이직랜드 임원진들이 사진 촬영을 하고 있다(왼쪽부터 이종민 에이직랜드 대표이사, 이석주 부사장, 송기출 DI본부장)